

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-024

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意，公司向不特定对象发行117,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,175,000手（11,750,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币117,500.00万元，扣除不含税的发行费用12,016,745.28元，实际募集资金净额为1,162,983,254.72元。上述募集资金已于2025年4月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月15日出具了《验证报告》（天健验[2025]6-4号）。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 4 月 15 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	117,500.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,201.67
二、募集资金净额	116,298.33
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	116,361.71
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.15
其他-具体说明（销户转出且永久补流）	8.17
加：	
募集资金利息收入（含理财收益）	71.71
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0

注：公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，公司将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至2025年12月31日，募集专户均已注销，节余募集资金8.17万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募

集资金四方监管协议》。公司于2025年4月23日和2025年4月30日在上海证券交易所网站分别披露了《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025年4月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	0	已注销
	招商银行无锡分行	511903003310018	0	已注销
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	中信银行上海分行	8110201011501885643	0	已注销
	交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605	0	已注销
偿还银行贷款及补充流动资金	交通银行上海张江支行	310066865013009418191	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”

2、募投项目存在无法单独核算效益的情况

（1）伟测半导体无锡集成电路测试基地项目2025年9月达到预定可使用状态，但截至2025年12月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目主要为公司业务提供现金流及减少公司负债，降低财务费用，涉及生产、营销等多个业

务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务持续稳定增长。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金180.07万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币77,606.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2025]6-486号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	58,938.02	58,938.02	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	18,488.01	18,488.01	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日

截至2025年4月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币

180.07万元，拟使用募集资金人民币180.07万元置换预先支付的发行费用，置换完成时间是2025年5月28日。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品	2025 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 日			
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行 上海张江支行	7 天通知	16,600.00	2025/4/30--2025/5/12	0.55
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6--2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3--2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7--2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7--2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8--2025/9/16	0.53
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行 无锡分行 新区支行	7 天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7 天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7 天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7 天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。

截至2025年12月31日，募集专户均已注销，实际节余募集资金8.17万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账日期	2025 年 4 月 15 日						
节余募集资金合计金额	8.17						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	3.01	用于补流					
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	5.04	用于补流					
偿还银行贷款及补充流动资金	0.12	用于补流					

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，伟测科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

平安证券股份有限公司认为，伟测科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对伟测科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2025 年 4 月 15 日											
本年度投入募集资金总额		116,361.71											
已累计投入募集资金总额		116,361.71											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	生产建设		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,018.42	18.42	100.03	2025 年 9 月	不适用	不适用	否

伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	生产建设		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.10	0.10	100.00	2024年12月	25,528.27	是	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	还贷及补充		27,500.00	27,500.00	27,500.00	26,343.18	26,343.18	-1,156.82	95.79	不适用	不适用	不适用	否
合计			117,500.00	117,500.00	117,500.00	116,361.71	116,361.71	-1,138.29	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详情请见报告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详情请见报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			详情请见报告正文“三、（五）节余募集资金使用情况”										
募集资金其他使用情况			不适用										

注 1：本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决。

注 2：伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目本期实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。本期为该项目建设完毕后第一年，本期收入已达到预计效益。